

2025年度上期

決算説明会資料

2025年11月13日



株式会社 メイコー
(証券コード：6787)

注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争等様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

1

2025年度上期実績

2

電子機器事業の取組

3

新規基板事業の取組

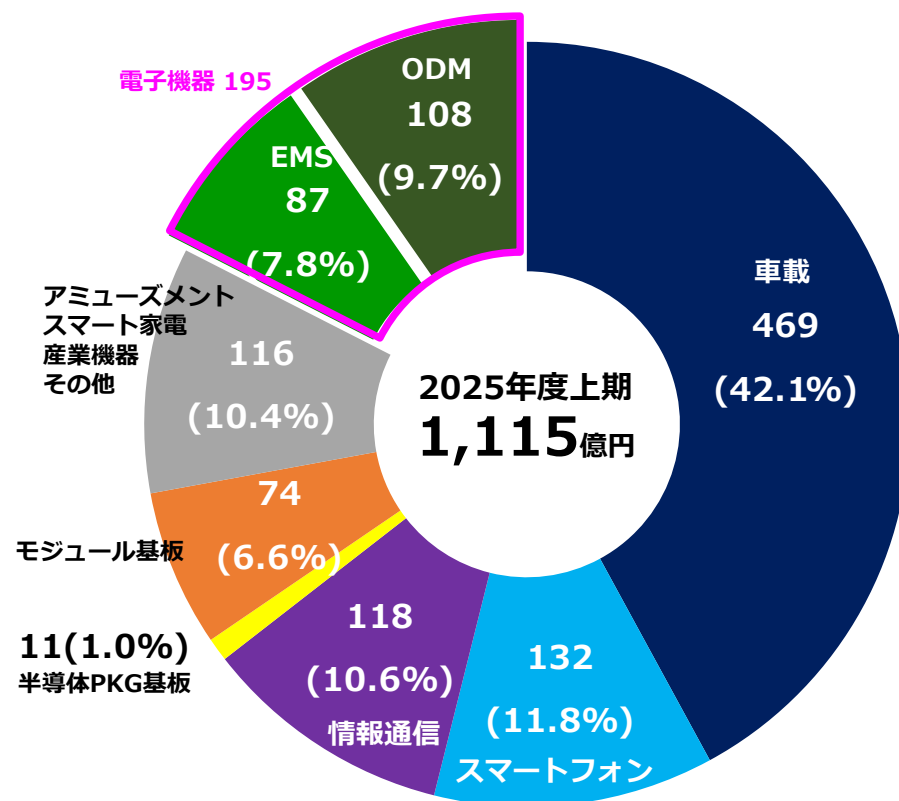
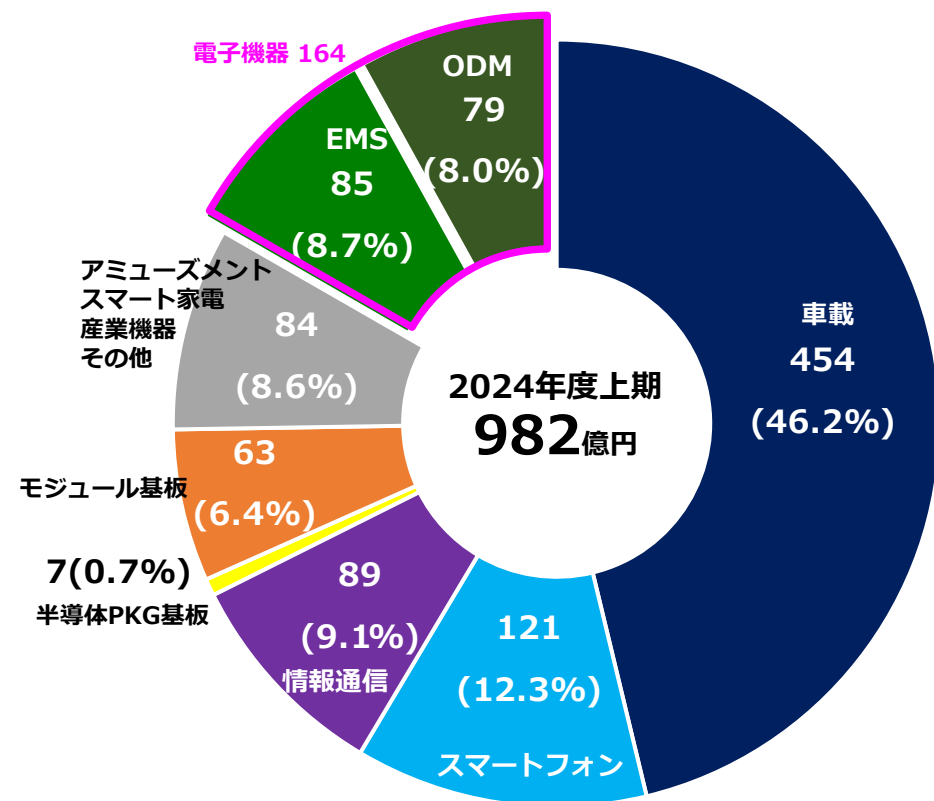
2025年度上期業績と通期業績予想

(単位：億円)

		2024年度		2025年度					
		上期実績	利益率	上期実績	利益率	下期予想	利益率	通期予想	利益率
売上高	基板	818		920		900		1,820	
	電子機器	164		195		215		410	
		982		1,115		1,115		2,230	
営業利益	基板	86	10.5%	100	10.9%	105	11.7%	205	11.3%
	電子機器	7	4.3%	14	7.2%	16	7.4%	30	7.3%
		93	9.5%	114	10.2%	121	10.9%	235	10.5%
経常利益		80	8.2%	114	10.2%	106	9.5%	220	9.9%
当期純利益		63	6.5%	94	8.4%	86	7.7%	180	8.1%
期中平均為替レート (JPY/USD)		152.46		146.04		143.00		144.52	

2025年度上期商品別実績

(単位：億円)

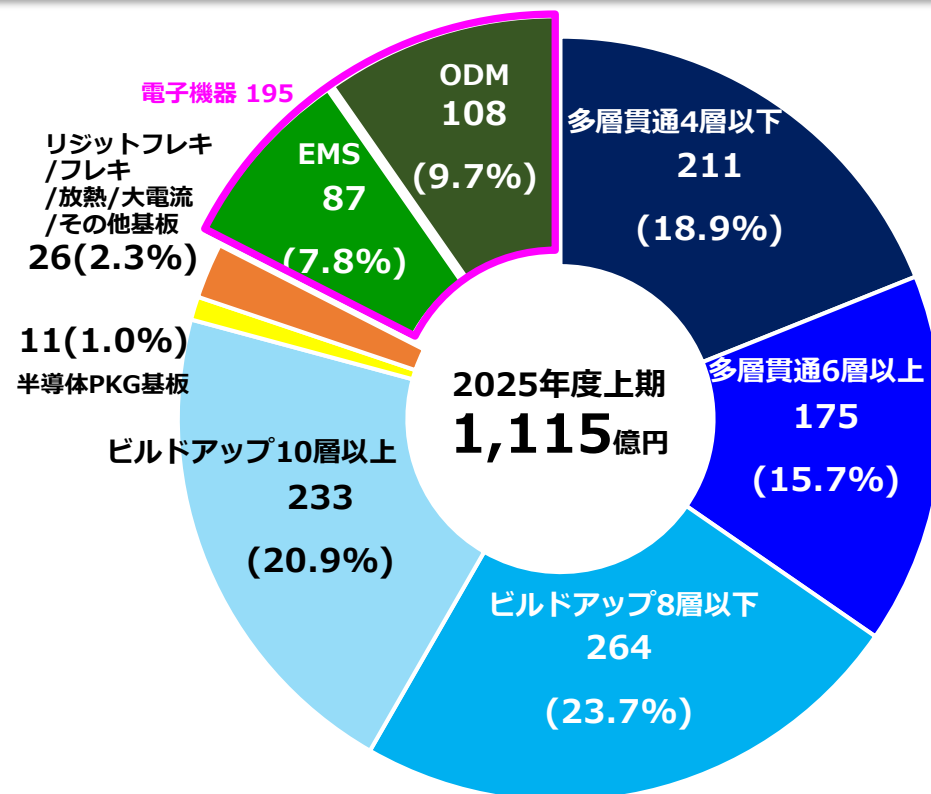
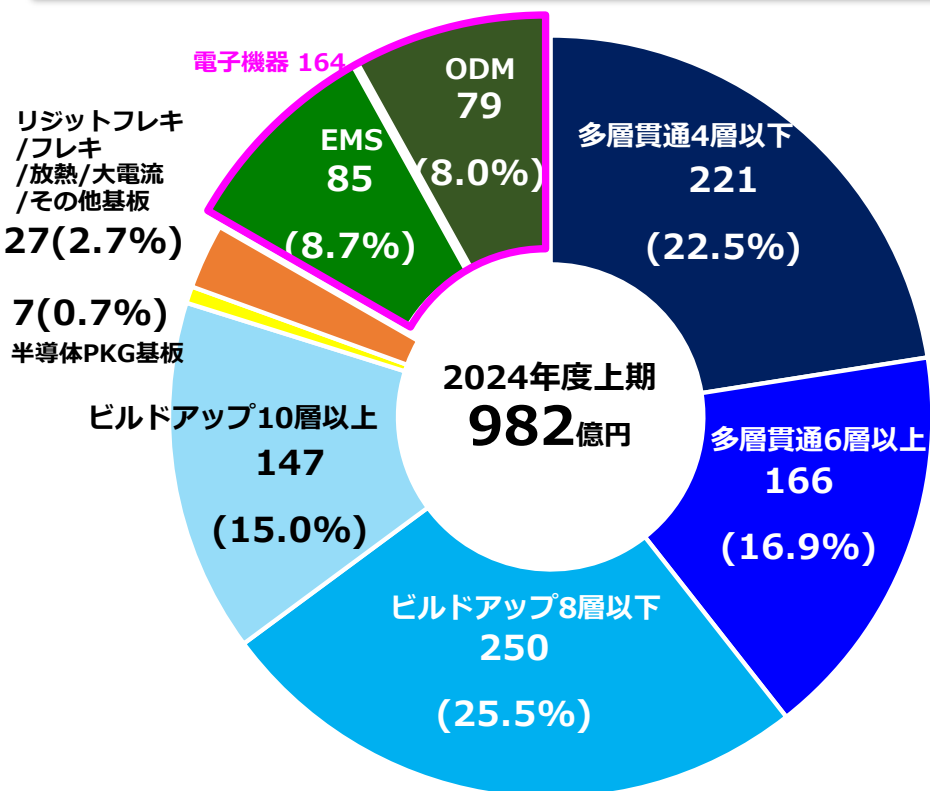


売上増減

商品	増減額	増減率	商品	増減額	増減率
車載	15	3.3%	モジュール基板	11	17.5%
スマホ・タブレット	11	9.1%	アミューズメント、スマート家電、産業機器その他	32	38.1%
情報通信	29	32.6%	EMS	2	2.4%
半導体PKG基板	4	57.1%	ODM	29	36.7%

2025年度上期仕様別実績

(単位：億円)



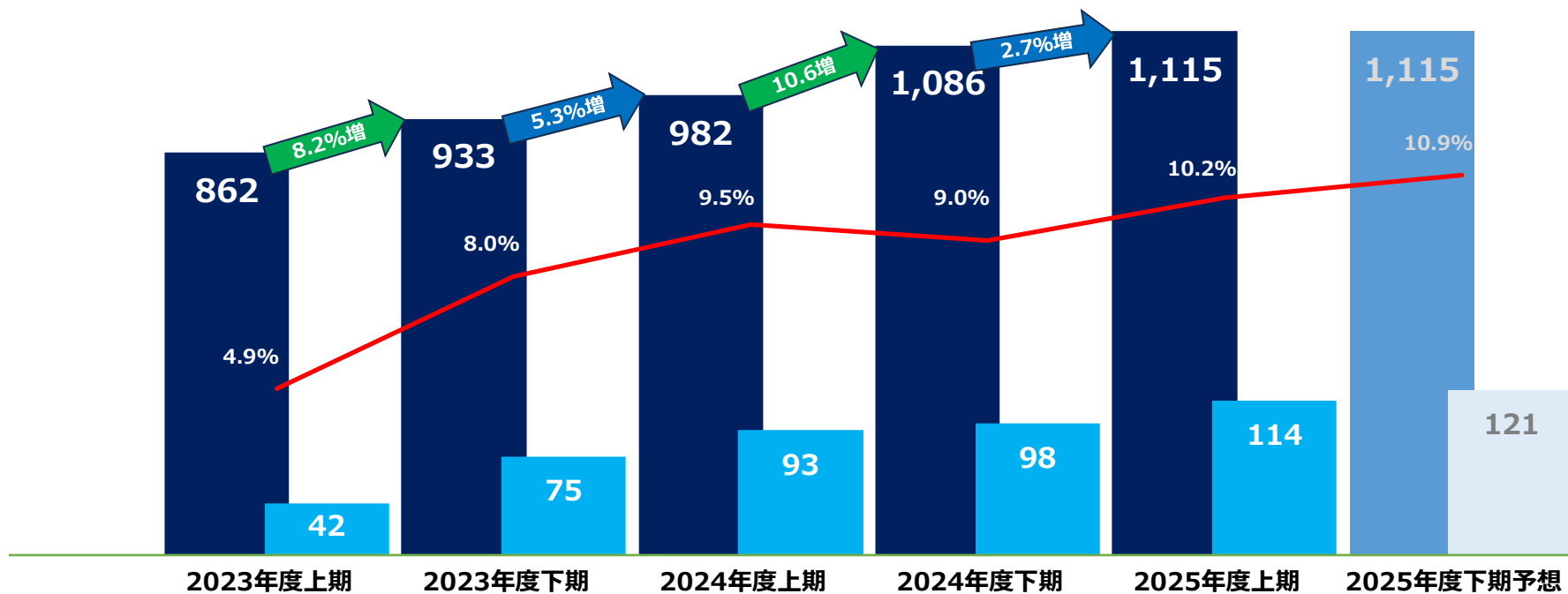
売上増減

仕様	増減額	増減率	仕様	増減額	増減率
多層貫通4層以下	-10	-4.5%	半導体PKG基板	4	57.1%
多層貫通6層以上	9	5.4%	リジッドフレキ、フレキ、放熱、大電流、その他基板	-1	-3.7%
ビルドアップ8層以下	14	5.6%	EMS	2	2.4%
ビルドアップ10層以上	86	58.5%	ODM	29	36.7%

業績の推移

(単位：億円)

■ 売上 ■ 営業利益 — 営業利益率



設備投資	129	70	71	226	241	269
EBITDA	95	133	155	161	178	194
時価総額	871	1,390	1,583	1,755	2,523	-
ROE	10.7%	11.5%	12.2%	14.9%	15.2%	13.0%
ROA	4.5%	5.3%	5.3%	6.7%	6.2%	5.7%
1株当たり 配当額	27	41	40	48	45	45

1

2025年度上期実績

2

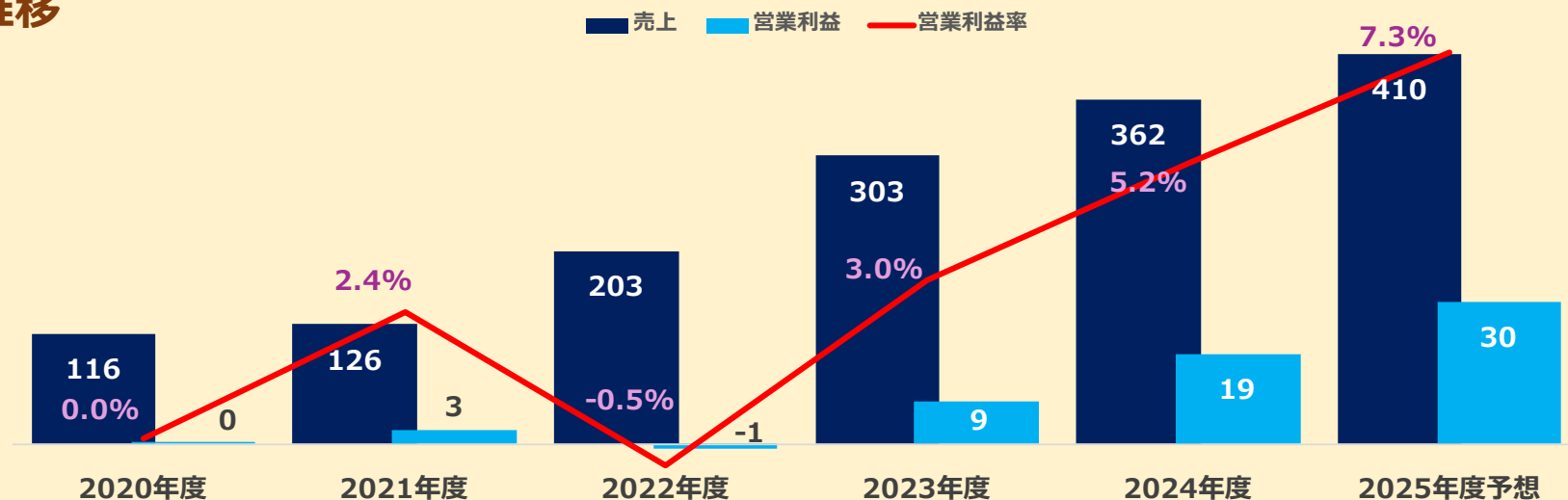
電子機器事業の取組

3

新規基板事業の取組

電子機器事業の取組

業績推移



強み

業務

特徴

開発・設計 ソフト・電子回路・メカ・工場自動化技術の技術者150名

基板実装

開発試作から大規模量産まで、最適な工場を提案
➡山形県南陽市、ベトナムタクタット、ベトナムハイズオン

電子機器事業の取組

更なる成長に向けた取組

南陽工場第2工場（今年10月に着工）

敷地面積	18,900m ²
延床面積	4,700m ²
投資規模	25億円
特徴	<u>半導体実装にも対応した先端工場</u>
稼働	2026年



ハイズオン第2工場（5階建て工場兼倉庫）

敷地面積	約40,000m ²
延床面積	約15,000m ²
投資規模	約20億円
特徴	実装と組立エリア
稼働	2027年



1

2025年度上期実績

2

電子機器事業の取組

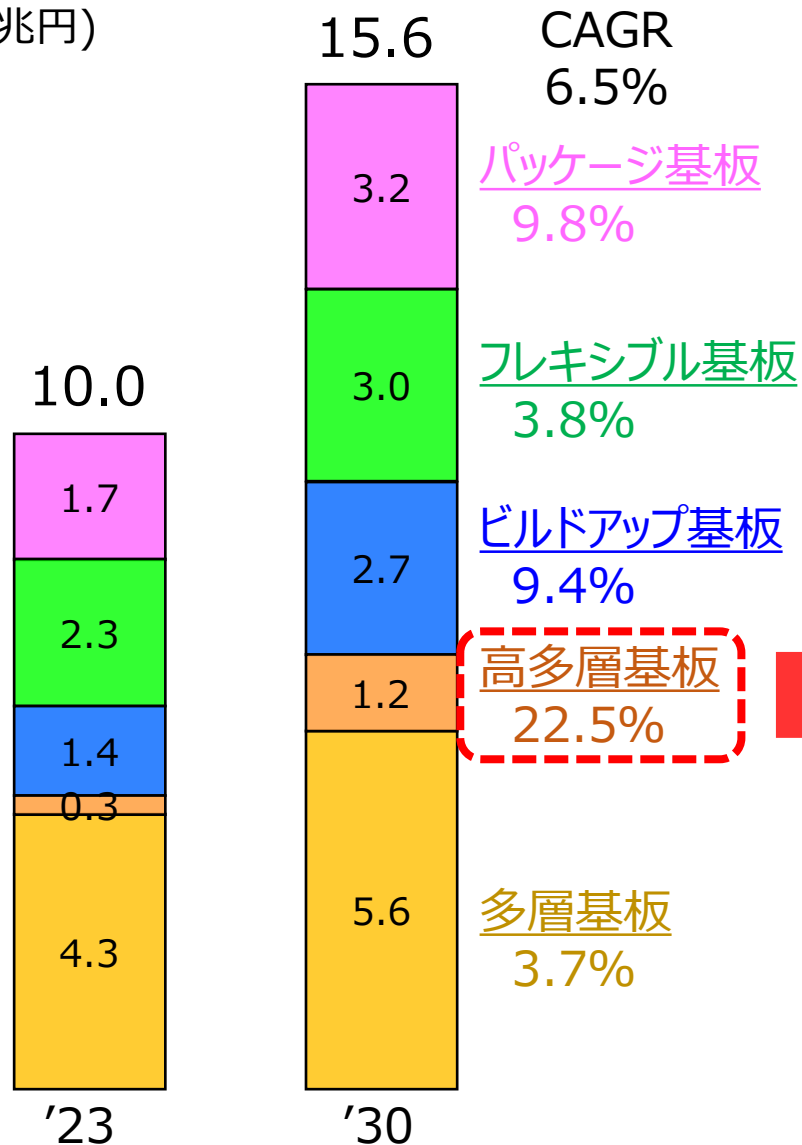
3

新規基板事業の取組

高多層基板市場予測

【プリント基板世界市場】

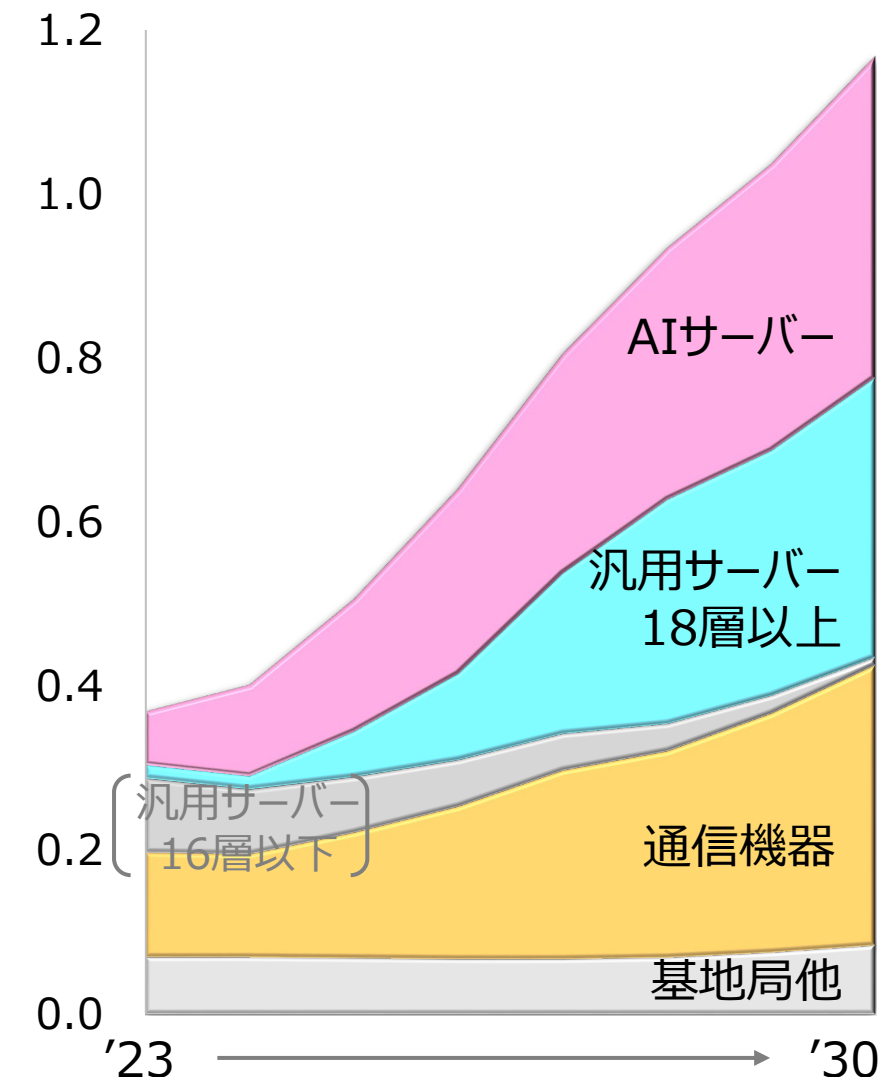
(兆円)



【高多層基板世界市場】

(兆円)

(高多層 : 18層以上)



AIサーバー向け各種基板の生産戦略

武漢工場

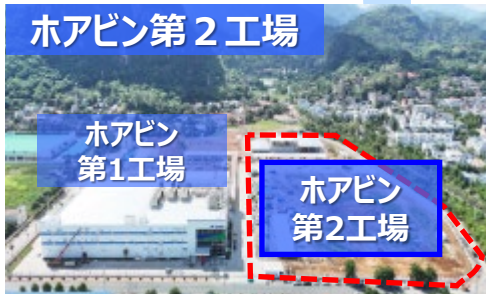


ネットワークボード・
メモリーモジュール



メモリーモジュール基板

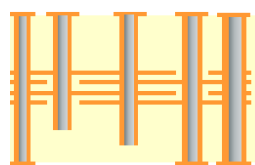
ホアビン第2工場



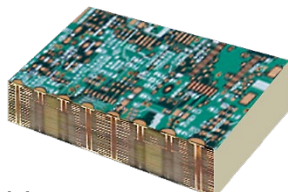
ホアビン
第1工場

ホアビン
第2工場

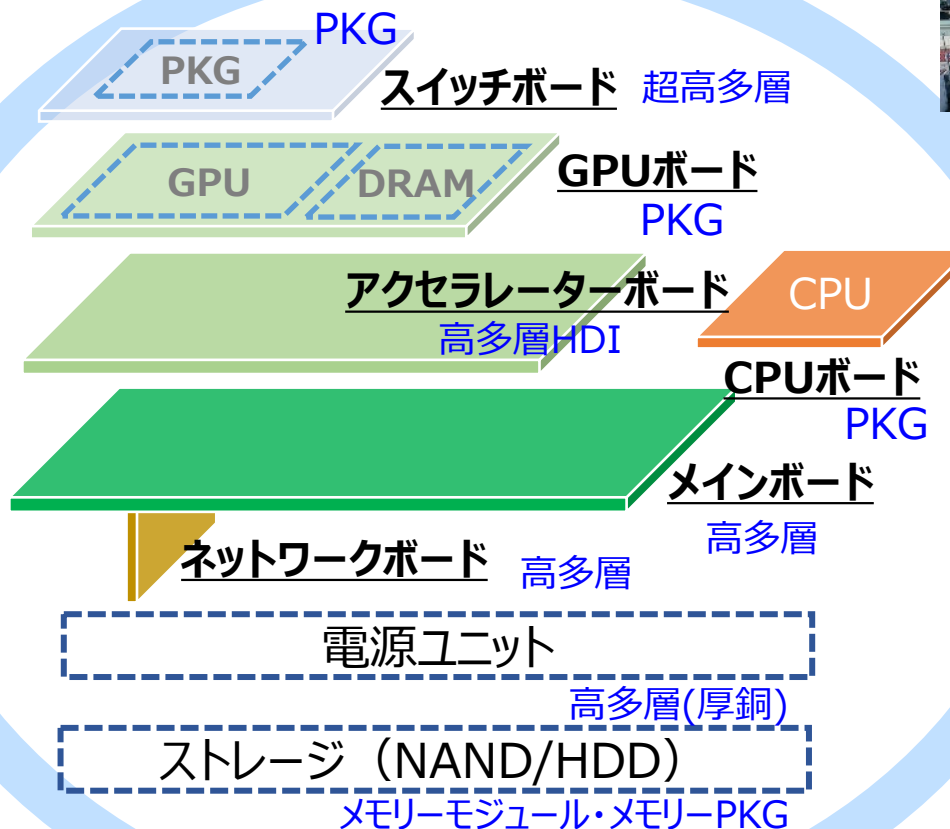
サーバーメインボード(J/V)



高多層基板



【サーバーを構成する基板概要】



石巻工場



PKG基板

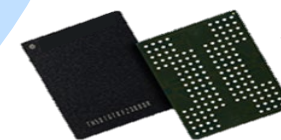


FC-BGA基板



ベトナム第3工場

メモリー向けPKG基板

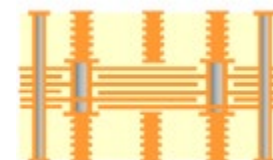


WB-CSP基板

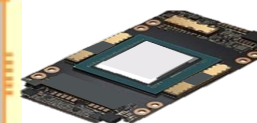


ベトナム第4工場

メモリーモジュール・アクセラレーターボード



高多層HDI基板



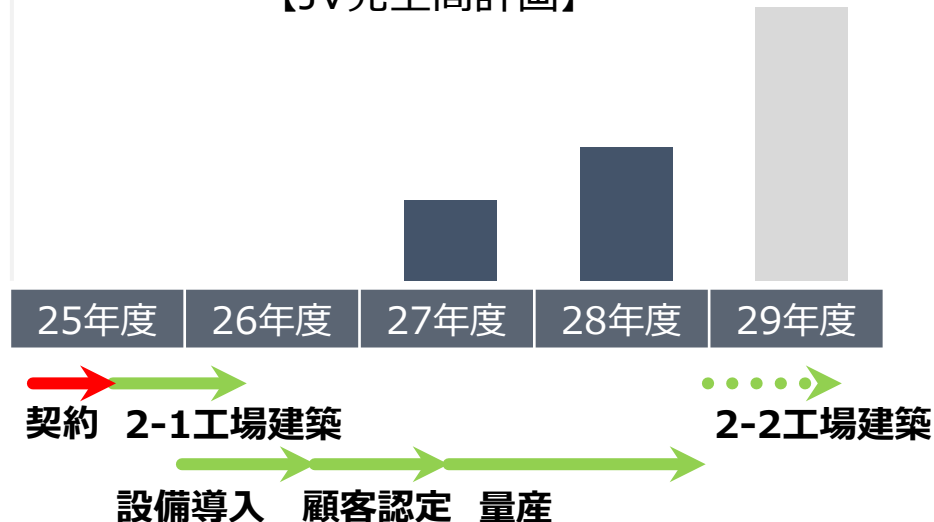
ACCL社とのJV会社について

今後の東南アジアに於けるAIサーバー需要増を見込み、ACCL社との提携で新規高多層事業に参入。

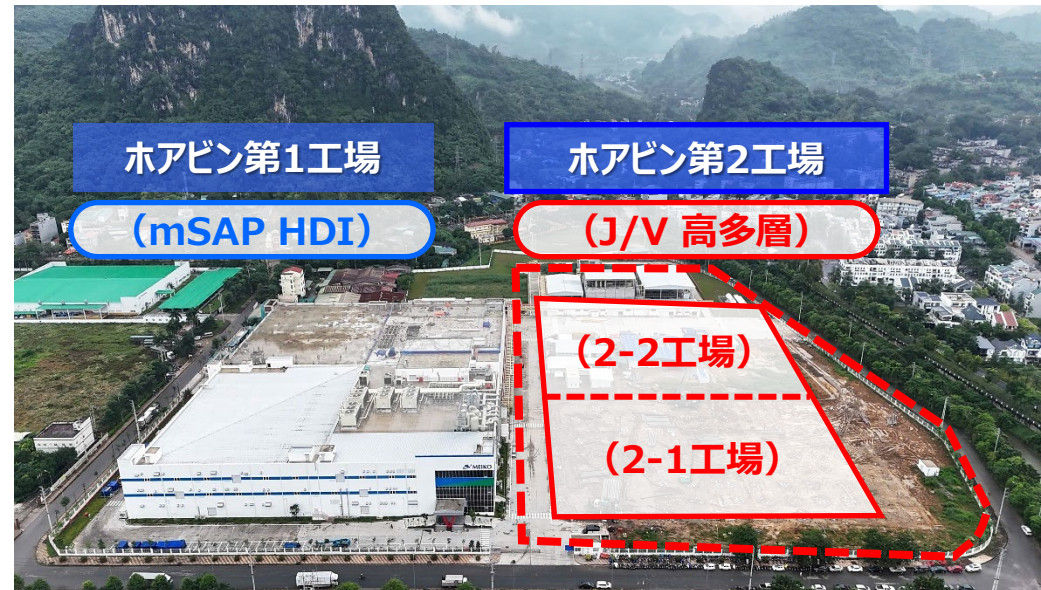
ACCL社とのJV会社概要

企業名	Allied Circuit Meiko Vietnam Co.,Ltd.
出資比率	ACCL70%、Meiko30%
設立	2025年11月
場所	ホアビン第2工場（延床：60Km ² ）
生産開始	2027年から順次開始予定
事業内容	AIサーバー向け高多層基板

【JV売上高計画】



(完成予想図)



ベトナム第4工場

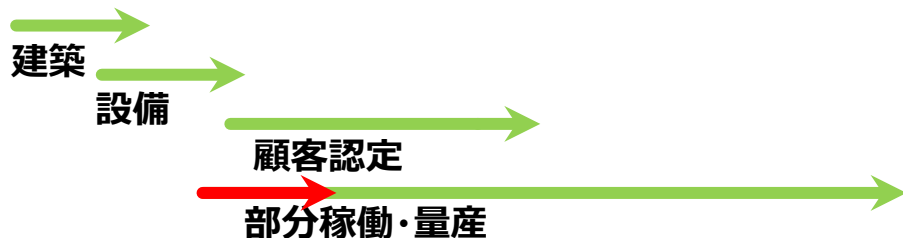
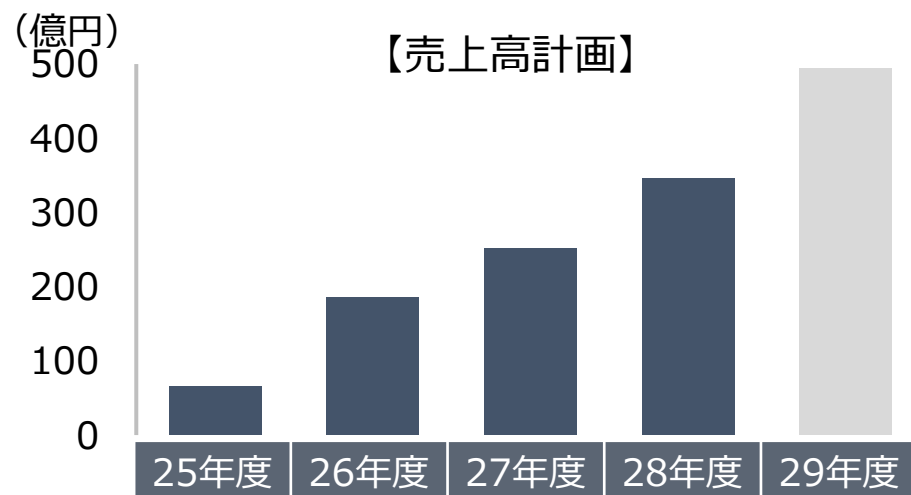
ベトナム第2工場は既にフル操業であり、'25/7月から部分稼働を実行中、今後の需要増に備える。

ベトナム第4工場 事業概要

延床面積 約60,000㎡ (15,000㎡×4F)

投資規模 約250億円

事業内容 第2工場(PCB)のキャパ補完
AIサーバー向け高多層HDI基板
メモリーモジュール基板

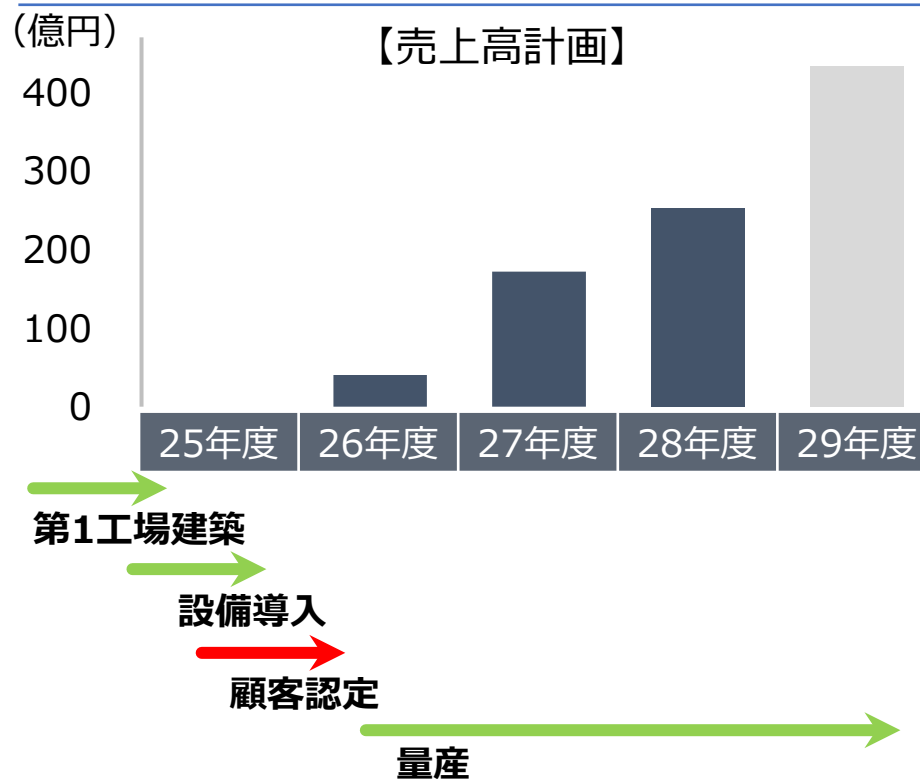


ホアビン第1工場

今後のAI機器需要増を受け、電力の優位性などを踏まえ、ホアビンでの最先端工場の立ち上げを実施中。

ホアビン第1工場 事業概要

敷地面積	約93,000m ²
延床面積	約60,000m ² （第1工場）
投資規模	約500億円（第1工場）
事業内容	最先端高密度ビルドアップ基板



ベトナム新工場の検討

今後のAI機器の軽薄短小化とベトナム拠点のHDI需要増に対応すべく、新生産拠点を検討。

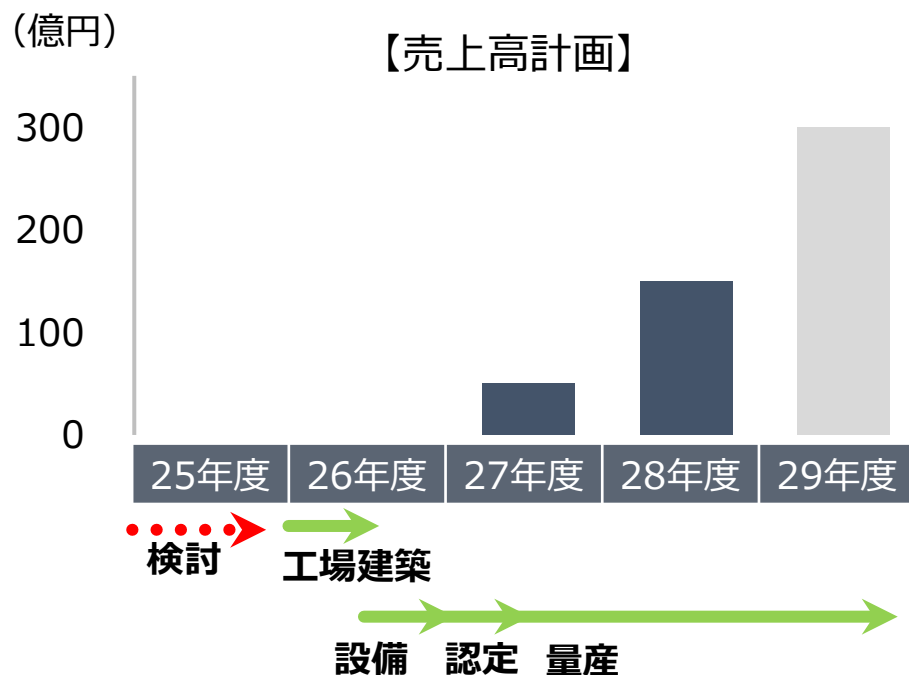
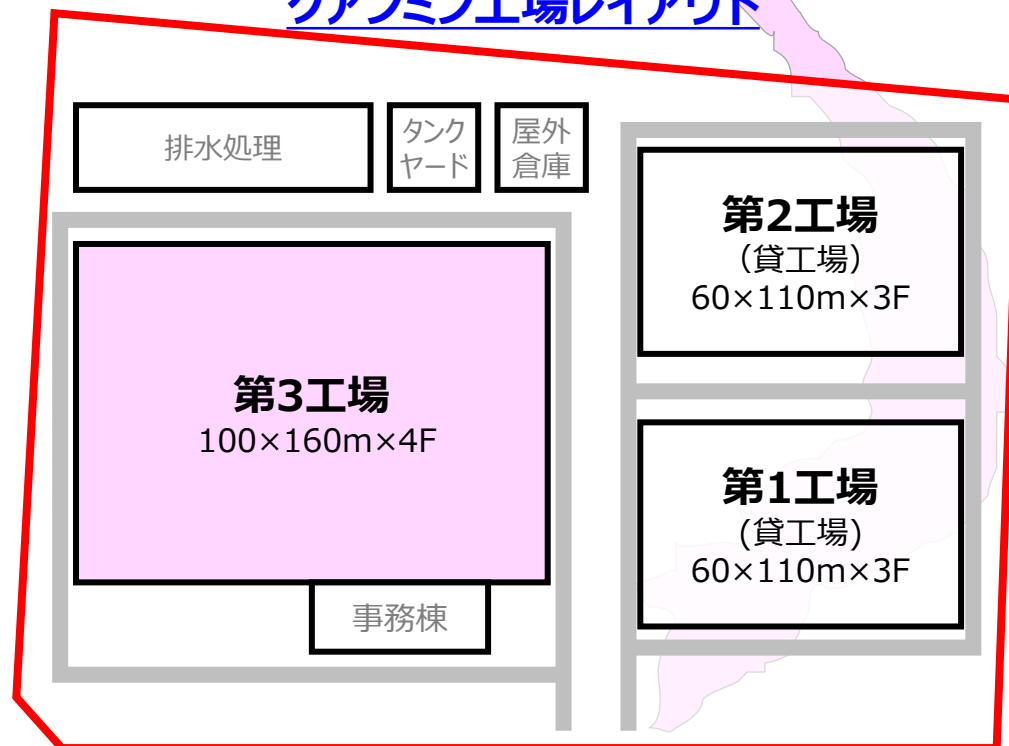
クアンミン第3工場 事業概要

敷地面積	約63,000m ²
延床面積	約53,000m ² （第3工場）
投資規模	約400億円
事業内容	最先端高密度ビルドアップ基板

（完成予想図）



クアンミン工場レイアウト

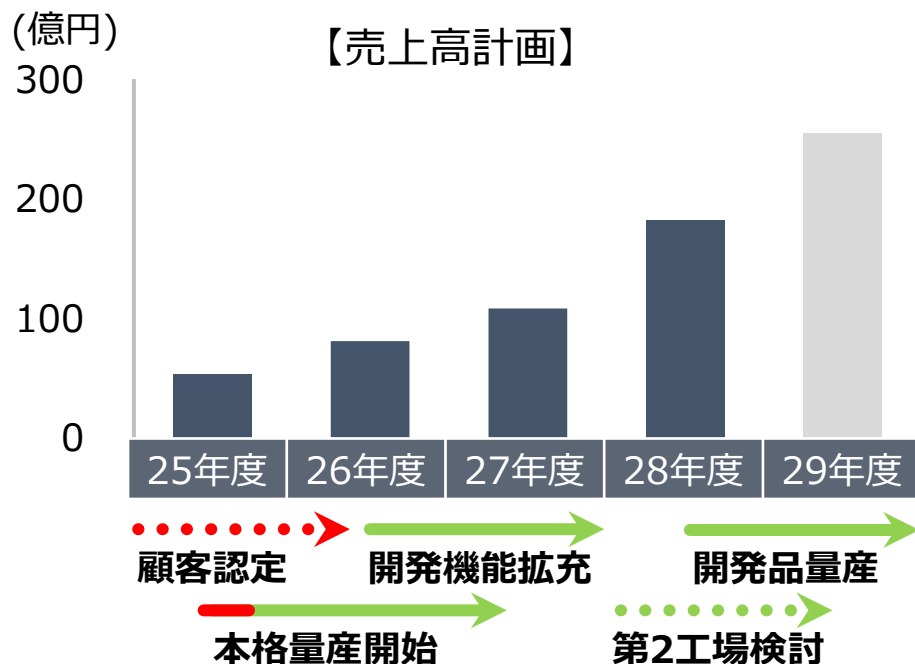


天童工場の状況

今年度下期から本格量産開始。来期からの需要増や新規開発品に対応した設備増設を実施中。

天童工場 事業概要

敷地面積	約65,000m ²
延床面積	約27,000m ² （第1工場）
投資規模	約200億円（第1工場）
事業内容	先端ビルドアップ基板量産工場 国内自動化設備開発・製造構想 基板技術開発センター機能



《天童工場》大規模ビルドアップエコスマート工場



《天童開発センター》

- ・産学連携開発案件強化
- ・米沢ODM事業との連携
- ・新規開発商品の開発・量産化
- ・部品内蔵基板の開発・量産化



部品内蔵基板